

Obudowa elektroniki - HSC-LR 3U KIT 2003 - 2201797

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Obudowy do wbudowania, System typu Lock and Release, Kolor: pomarańczowy, Szerokość: 16,2 mm

Właściwości produktu

- Artykuł należy do rodziny produktów ME-IO
- Montaż beznarzędziowy
- Podłączenie czołowe Push-in
- Możliwość stosowania do maks. 18-pinowych złączy przednich

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 046356 911580
GTIN	4046356911580
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,005 kg
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Informacje ogólne

Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Materiał obudowy	Poliamid
Kolor	pomarańczowy

Wymiary

Długość	33 mm
Szerokość	16,2 mm

Obudowa elektroniki - HSC-LR 3U KIT 2003 - 2201797

Dane techniczne

Dane techniczne

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

